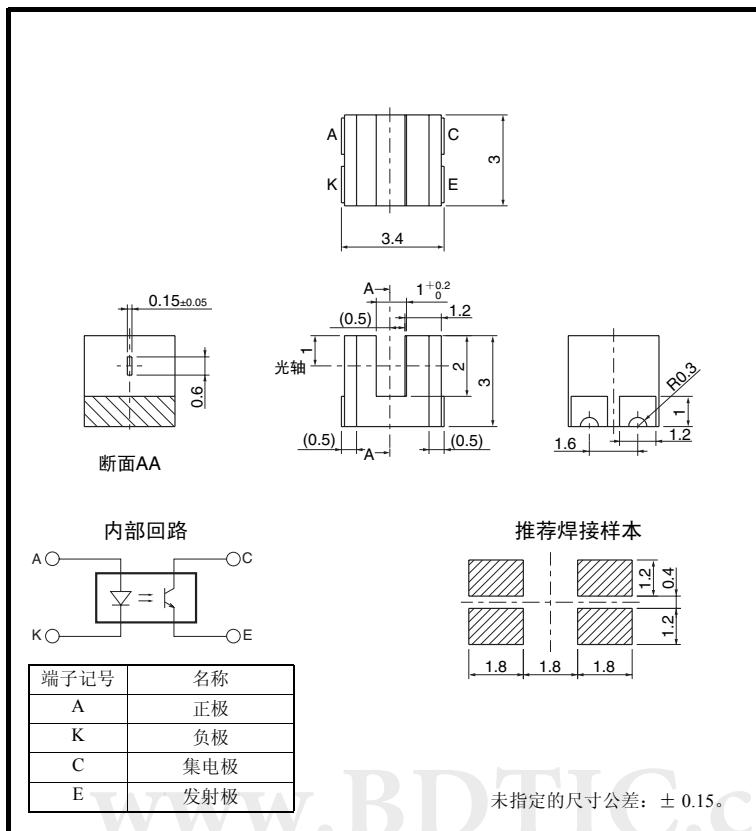


■ 外形尺寸

(单位: mm)



■ 特征

- 实现传感器宽度 3.4mm、凹槽宽度 1mm 的超小型传感器
- 印刷线路板表面实装型
- 高分辨率 (狭片宽度 0.15mm)

■ 绝对最大额定值 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

项目		记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I_F	25 *1	mA
	正向脉冲电流	I_{FP}	100 *2	mA
	反向电压	V_R	5	V
受光侧	集电极发射极之间的电压	V_{CEO}	20	V
	发射极集电极之间的电压	V_{ECO}	5	V
	集电极电流	I_C	20	mA
集电极损耗		P_C	75 *1	mW
动作温度		T_{opr}	-30 ~ +85	°C
保存温度		T_{stg}	-40 ~ +90	°C
焊接温度		T_{sol}	350 (手工焊接) 255 (回流焊接) *3	°C

*1 环境温度超过 25 °C 时, 请参阅温度额定值图。

*2 占空比 1%、脉冲宽度 0.1ms

*3 焊接时间为手工焊接 3 秒以内、回流焊接 10 秒以内

■ 电气及光学特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

项目	记号	特性值			单位	条件
		MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V_F	—	1.1	1.3	V $I_F = 5\text{mA}$
	反向电流	I_R	—	—	10	μA $V_R = 5\text{V}$
	最大发光波长	λ_P	—	940	—	nm $I_F = 20\text{mA}$
受光侧	光电流	I_L	50	150	500	μA $I_F = 5\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$
	暗电流	I_D	—	—	100	nA $V_{CE} = 10\text{V}, 0 \text{lx}$
	泄漏电流	I_{LEAK}	—	—	—	μA —
	集电极发射极之间的饱和电压	$V_{CE(\text{sat})}$	—	0.1	0.4	V $I_F = 20\text{mA}, I_L = 50\mu\text{A}$
	最大光谱灵敏度波长	λ_P	—	900	—	nm —
上升时间	t_r	—	10	—	μs	$V_{CC} = 5\text{V}, R_L = 1\text{k}\Omega$ $I_L = 100\mu\text{A}$
下降时间	t_f	—	10	—	μs	$V_{CC} = 5\text{V}, R_L = 1\text{k}\Omega$ $I_L = 100\mu\text{A}$

■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・集电极损耗的温度额定值图

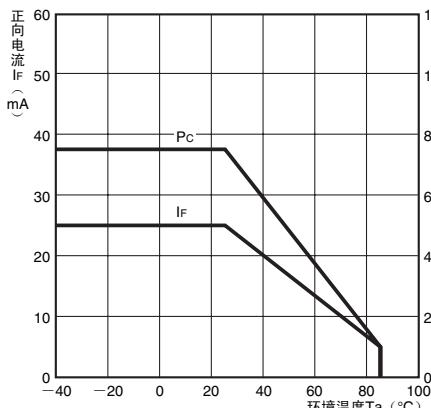


图 4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

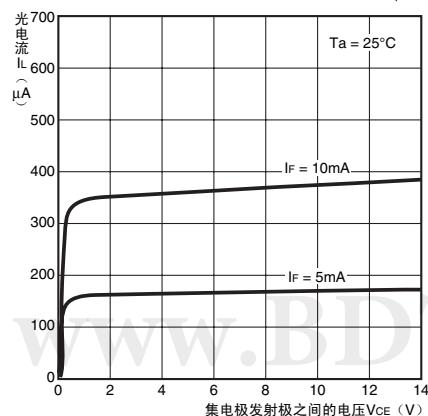


图 7. 应答时间—负载电阻特性 (TYP.)

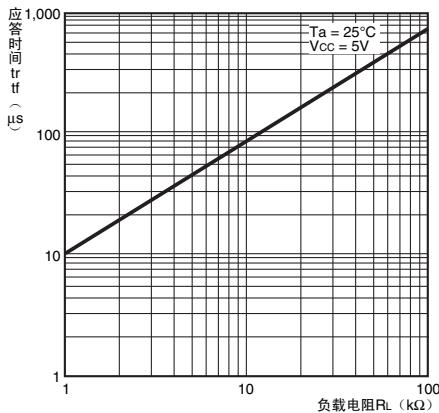


图 10. 应答时间测定回路

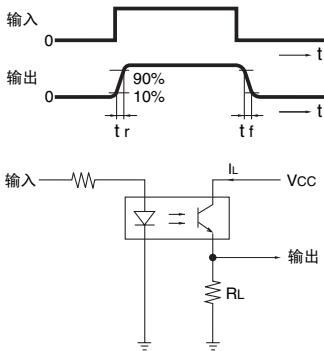


图 2. 正向电流—正向电压特性 (TYP.)

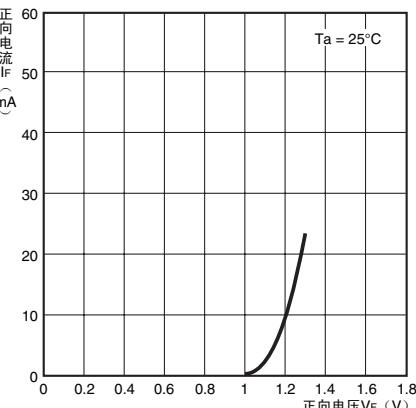


图 5. 相对光电流—环境温度特性 (TYP.)

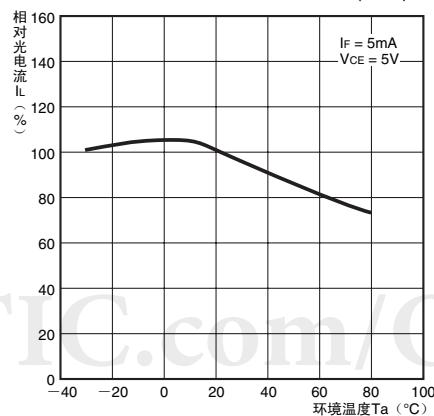


图 8. 检测位置特性 (TYP.)

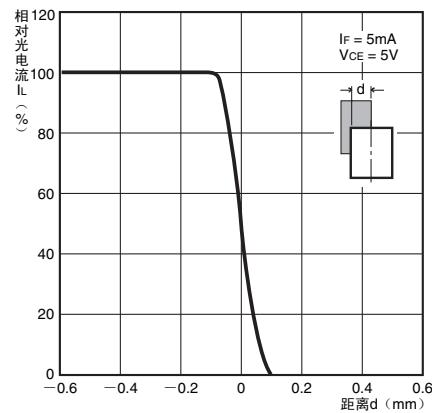


图 3. 光电流—正向电流特性 (TYP.)

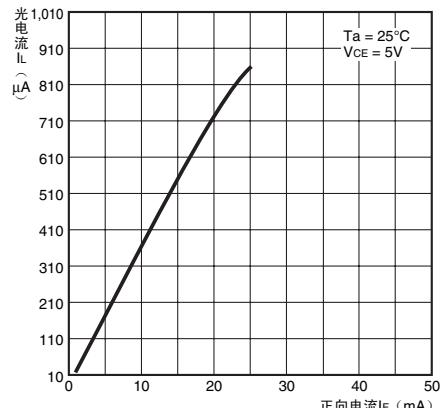


图 6. 暗电流—环境温度特性 (TYP.)

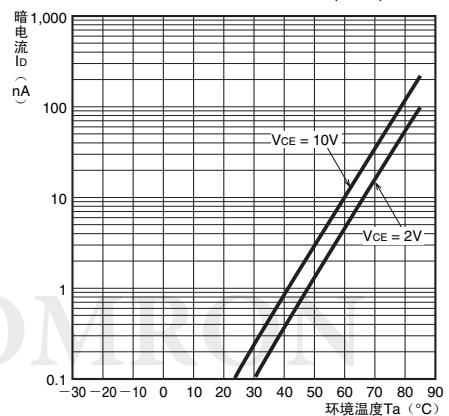
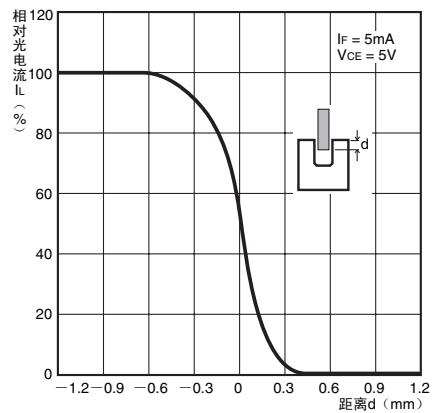


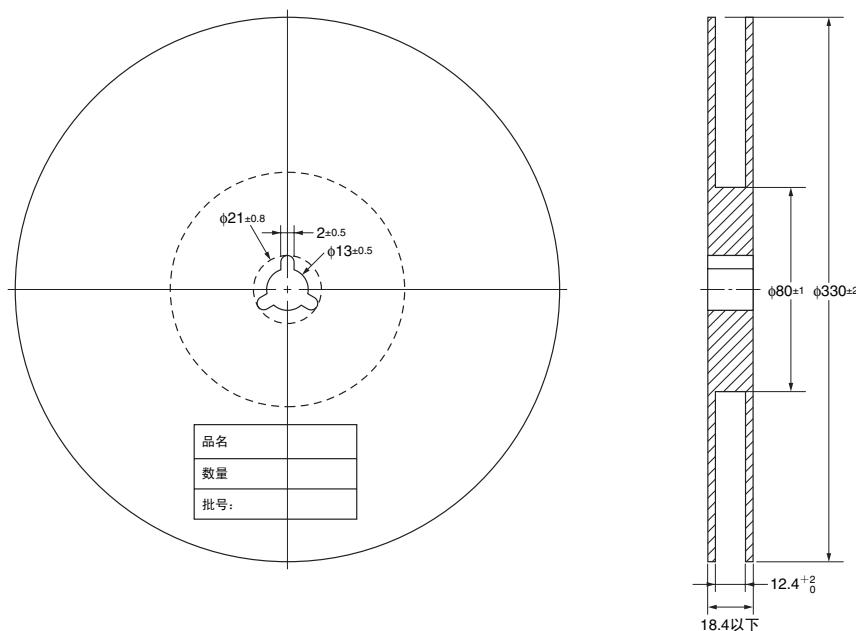
图 9. 检测位置特性 (TYP.)



EE-SX1107

■ 编带规格

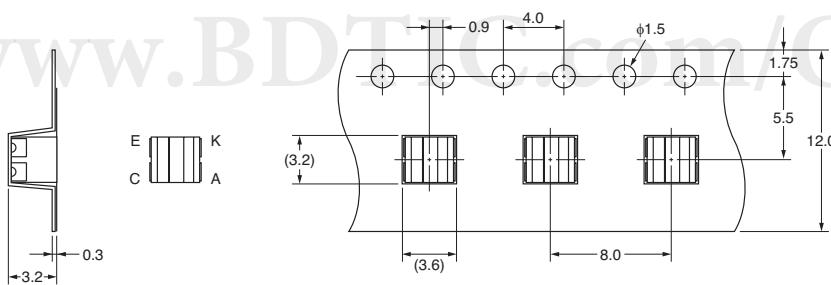
● 卷轴形状尺寸 (单位: mm)



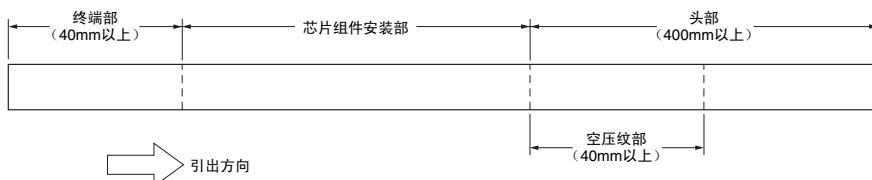
微型光敏传感器

EE-SX1107

● 编带尺寸 (单位: mm)



● 编带形式



● 数量

2,500 个 / 卷

■ 实际安装时须注意

● 回流焊接

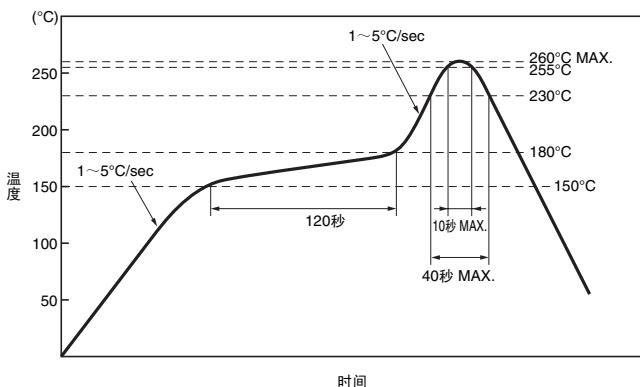
(1) 建议使用以下规格的锡膏。

溶化温度: 216 ~ 220 °C

成分 : Sn-3.5Ag-0.75Cu

(2) 建议金属面罩厚度 $t = 0.2 \sim 0.25\text{mm}$ 。

(3) 请设定回流炉的相关条件, 使产品表面温度符合下图温度曲线。



● 手工焊接

(1) 请使用共晶焊或银焊。

(2) 请使用 25W 以下的烙铁, 并将烙铁温度控制在 350 °C 以下。

(3) 焊接时, 每个端子的时间不可超过 3 秒。

(4) 焊接产品需等其恢复常温后, 才能进行其他处理。

■ 保存方法

为避免产品吸收湿气, 开封前最好将产品保存于干燥箱内。若没有干燥箱, 建议保存条件如下。

温度: 10 ~ 30 °C

湿度: 60%RH 以下

产品外包装具防潮功能, 请在开封后 48 小时内进行回流焊接, 且环境温度低于 30 °C、湿度低于 80%RH。

若开封后不得不再保存, 请保存于干燥箱或再进行密封。

■ 烘烤

若防潮包装超过 6 个月, 或开封超过 48 小时, 请在使用前按照下述条件进行烘烤。

烘烤条件: 60 °C × 24 小时以上 (卷起状态)

80 °C × 4 小时以上 (散开状态)